



## **Lista serviciilor de digitalizare oferite IMM-urilor/ APL-urilor**

### **în cadrul proiectului EC/101083410 –WeH și POCIDIF/1147/2/1/161799 Wallachia eHUB (WEH)**

**Partener WEH: ASOCIATIA PENTRU PROMOVAREA TEHNOLOGIEI ELECTRONICE - Romania**

<b>Categorie serviciu</b> (cf. Grant Agreement)	<b>Tip/ subcategorie serviciu</b> (cf. Grant Agreement)	<b>Număr servicii disponibile</b>	<b>Cost unitar/ total</b> (cf. Grant Agreement)	<b>Denumire/ descriere serviciu disponibil</b>
WP 3. Servicii de dezvoltare a competențelor și de formare profesională (Skills Development and Training Services)	Sesiuni de instruire pe soluții digitale (Training sessions on digital solutions)	9	3000 euro/	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Cursuri de specialitate pentru proiectare electronică pentru fabricație (DFM) folosind inginerie asistată de calculator (CAE) și proiectare asistată de calculator (CAD) conform standardelor industriei (certificare IPC la cerere);</li> <li>2. Instruire și simulare pentru proiectarea plăcilor de circuite imprimate.</li> </ul>
WP 4. Servicii de testare înainte de a investi (Test before invest services)	Consultanță pentru integrarea soluțiilor digitale (Consulting for integrating digital solutions)	27	3000 euro/	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Servicii de Inginerie Asistată de Calculator (CAE) în domeniul packaging electronic și al dezvoltării modulelor electronice.</li> <li>2. Consultanță tehnică și tehnologică pentru CAD (Computer Aided Design) și CAM (Computer Aided Manufacturing).</li> <li>3. Modelarea și simularea multicriterială a modulelor și subansamblurilor electronice (electromagnetic, mecanice, management termic, test de stres și analiza integrității semnalului).</li> <li>4. Dezvoltarea, asamblarea și testarea prototipurilor electronice.</li> </ul>
WP 5. Servicii de inovare ecosistem și creare de rețele (Ecosystem Innovation and Networking Services)	Activități de networking și matchmaking (Networking and matchmaking activities)	2	1410 euro/	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Participare la conferința și expoziția IEEE „International Symposium for Design and Technology in Electronic Packaging (SIITME)” ca punct de întâlnire pentru rezultatele cercetării academice și reprezentanții industriei din regiune - <a href="http://www.siitme.ro">www.siitme.ro</a></li> <li>2. Evenimentul „Technologies of Interconnections in Electronics (TIE)” - Proiectarea modulelor și ansamblurilor electronice - <a href="http://www.tie.ro">www.tie.ro</a></li> </ul>

Valoare totală servicii subvenționate disponibile în ofertă: **110.820 euro**